



Flux sans nettoyage IF 2005K

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique IF 2005K

Ver: 3.12 15-01-16

Page 1

Flux de brasage sans nettoyage, sans halogènes

Description:

Interflux® IF 2005K est un flux sans nettoyage à faible pourcentage de matière solide, spécialement développé pour le brasage à la vague sans plomb.

IF 2005K peut aussi être utilisé pour le brasage à la vague SnPb et le brasage sélectif, néanmoins dans ces cas, respectivement l'IF 2005M et l'IF 2005C sont les premiers choix.

Le système d'activation du flux IF 2005K a été développé pour obtenir un mouillage optimal sur pratiquement toutes les finitions sans plomb, y compris OSP (Cuivre passivé).

Le flux est absolument sans halogènes, par conséquent ce flux est le plus sûr pour la fiabilité des cartes électroniques dans tous les secteurs de l'industrie électronique.

Tous les constituants du flux peuvent s'évaporer lors du processus de brasage.

L'absence de colophane et de résine dans le flux IF 2005K permet d'obtenir des cartes parfaitement propres et sans résidus collants après brasage, cela garantit une excellente testabilité des cartes au testeur in situ. La pollution de la machine et des cadres de brasage est très faible comparée aux autres flux.

Le flux est classé dans les normes IPC et EN comme OR/L0.



La photo n'est pas contractuelle

Propriétés physiques

Apparence	Liquide incolore
Matière solide	2,5% ± 0,3
Densité à 20°C	0,810 g/ml — 0,812 g/ml
Pourcentage d'eau	3-4%
Indice d'acide	18 – 22 mg KOH/g
Point éclair T.O.C	15°C (59°F)



RoHS
compliant

Informations

<i>Application</i>	2
<i>Préchauffage</i>	2
<i>Contact vague(s)</i>	2
<i>Résidus blancs et nettoyage</i>	3
<i>Manipulation</i>	3
<i>Tests de fiabilité</i>	3
<i>Conditionnement</i>	4

Avantages:

- Absolument sans halogènes
- Brasage avec plomb **et** sans plomb
- Approprié pour les fluxeurs spray, mousse, "drop jet et dip fluxing"
- Très grande compatibilité avec les vernis de tropicalisation



Application du flux

1. Fluxeur mousse:
Afin d'obtenir une excellente mousse, le niveau de flux dans le fluxeur doit être de 2 à 3 cm au dessus de la pierre poreuse. L'utilisation d'un couteau d'air entre le fluxeur et le préchauffage est impératif.

2. Fluxeur spray:
Nous vous conseillons d'utiliser un spray qui fluxe la carte à l'aller et au retour. Maintenez une pression de flux basse.

Régalez la vitesse de déplacement de la buse de façon que chaque point est fluxé deux fois (une fois de chaque côté). Ainsi les bandes de fluxage se chevauchent à 50% de leurs largeurs et vous obtiendrez la meilleure répartition possible du flux sous la carte. Utilisez un carton, en lieu et place d'une carte, pour vérifier l'homogénéité du dépôt de flux. Retirez le carton de la machine avant qu'il

n'atteigne le préchauffage.

En complément du carton vous pouvez utiliser une plaque de verre ou un circuit nu qui vous permettront d'évaluer la quantité de flux déposée. Ne pas oublier de les retirer de la machine avant qu'ils n'atteignent le préchauffage.

Idéalement il ne doit pas avoir de gouttes de flux sous la plaque de verre ou le circuit nu. Les gouttes seront difficiles à

évaporer lors du préchauffage.

Réduire la quantité de flux déposé jusqu'à ce que des défauts, typiquement causés par une quantité de flux trop basse, comme des courts circuits, stalactites', etc... apparaissent. Après, augmenter la quantité jusqu'à ce qu'ils disparaissent.

Préchauffage

Le préchauffage, mesuré sur le dessus du circuit, doit être compris entre 100°C et 160°C. Ces valeurs sont le résultat de nombreuses expériences industrielles. Le flux IF 2005K peut accepter des valeurs basses pourvu que les solvants soient totalement évaporés avant

le contact avec la vague(s).

Les températures de préchauffage au dessus de 150°C doivent avoir un temps de préchauffage assez court afin de ne pas détruire totalement le flux avant le contact avec la vague (s). Évitez des températures préchauffage de type convectif supérieures à 150°C. Tou-

jours tenir compte des propriétés physiques de la carte et des composants afin

d'obtenir le meilleur brasage possible.

Pente: 1-3°C/s

Contact vague(s)

Si vous travaillez en simple vague, le temps de contact doit être compris entre 3 - 4s. Si vous travaillez en double vague, le temps de contact de la première vague doit être compris entre 1 - 2s et 2 - 4s pour la

deuxième vague.

Vous pouvez obtenir un résultat satisfaisant avec un temps de contact plus court, cependant un temps de contact plus important aura l'avantage de bien éliminer le flux lors du contact



T° mesurée sur le dessus de la carte en process sans plomb.

vague(s). La limite maximale du temps de contact sera déterminée par l'apparition

des ponts et les propriétés physiques de la carte et des composants.



Résidus blancs et nettoyage

Résidus blancs

La formation de résidus blancs après brasage peut être attribué à plusieurs causes. Le brasage à la vague avec des cadres de brasage ou le brasage sélectif, la surface de dépose du flux est parfois plus grande que la surface

qui est en contact avec la vague. Cela peut causer des résidus blancs. Une quantité de flux déposé trop grande ou la condensation des vapeurs de flux peuvent également causer des résidus blancs. Ces résidus sont sûrs. Les résidus ne sont pas col-

lants et ne poseront pas de problèmes de contact. Moins de flux déposé, plus de chaleur et plus de contact de vague peuvent réduire ces résidus. Le brasage avec IF 2005M donne moins de résidus, mais possède une plus petite fenêtre de process.

Nettoyage

Les résidus peuvent être retirés avec une brosse ou peuvent s'évaporer avec de la chaleur. Le flux peut être nettoyé avec la plupart des produits de nettoyage conventionnels.

Manipulation

Stockage

Le flux doit être stocké dans les bidons d'origines fermés, à des températures entre +5° to +25°C

Sécurité

Toujours lire la fiche de sécurité du produit.

Contrôle de densité

La densité du flux IF 2005K peut être mesurée à l'aide d'un densimètre et un thermomètre pour le contrôle de la température. Si cela est nécessaire vous pouvez ajuster la densité du flux à l'aide du diluant T 2005M. En vous aidant du tableau de dilution. Utilisez uniquement le diluant T 2005M pour diluer le flux IF 2005K.

Mesure de titration

La mesure de la quantité de matière solide du flux IF 2005K peut être faite à l'aide d'une titration. Les liquides de titration sont disponibles chez Interflux. Si cela est nécessaire ajustez la quantité de matière solide à l'aide du diluant T 2005M en vous aidant du tableau de titration.

Réutilisation

Ne pas mélanger du flux usage avec du flux neuf.

Résultats des tests de fiabilité

Conformes aux normes EN 61190-1-2(2002) et IPC J-STD-004A

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Miroir de cuivre	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes		
Chromate d'argent (Cl, Br)	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Classification du flux	OR LO	J-STD-004A
Environnement		
Test SIR	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3



Conditionnement:

IF 2005K est disponible en conditionnement suivant:

Bidon de 10 litres en polyéthylène

Bidon de 25 litres en polyéthylène

Bidon de 200 litres en polyéthylène

Nom commercial du produit : IF 2005K No-Clean, Halide Free Soldering Flux

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com